

ブライト® (金属被覆粉体)

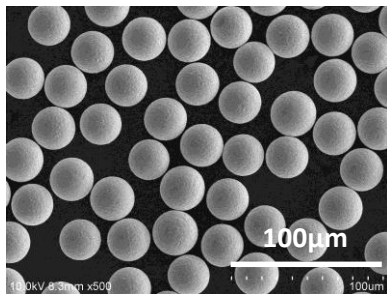
Metal-Coated Powder

●特徴

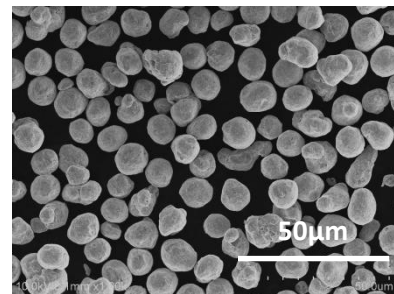
- ・当社が開発した粉体への無電解めっき技術により、各種特性(材質、形状、硬さ、粒径およびその分布)を持つ粉体をベースに、様々な金属被覆粉体(Au、Ni、Pd)を提供可能。
- ・個々の粒子は緻密なめっき皮膜でバラツキなく被覆され、めっき厚みや表面形態(平滑、突起)制御が可能。
- ・被覆しためっき皮膜は密着強度に優れ、導電性粒子として高い信頼性が得られる。

オリジナルの各種金属被覆粉体を用意しているほか、オーダーメイドの金属被覆粉体の製造やお持ちの粉体への受託めっき加工についてもご相談を承ります。

●めっき品SEM像(一例)



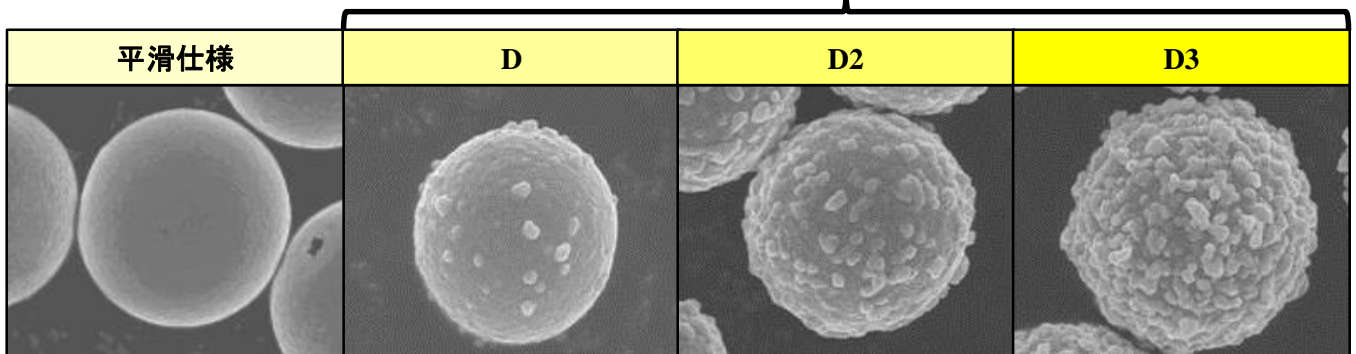
6GNR30-MX (×500)
Au-Ni被覆樹脂粒子



7GNM8-NiS (×1000)
Au被覆Ni粒子

●表面形態の制御

突起仕様(Dタイプ)

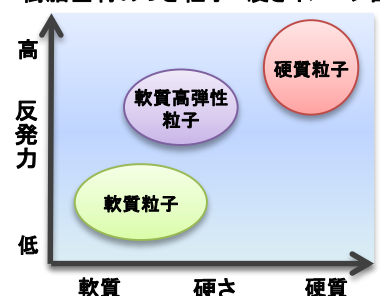


●ブライト製品ラインアップ

- ・基材粒子 樹脂粒子、Ni粒子など
- ・粒径 2.5~50µm(基材粒子により異なる)
- ・硬さ ご要望に応じた硬さの粒子をご紹介します。
- ・めっき膜厚 Ni: 50nm~200nm、Au: 10nm~40nm
- ・表面形態 平滑仕様、突起仕様

なお、上記範囲外の仕様への対応についてもご相談承ります。

樹脂基材めっき粒子 硬さイメージ図



●用途例

異方導電性フィルム・ペースト用導電フィラー、
液晶パネル用導電性スペーサーなど

日本化学工業株式会社

機能品営業部 tel. 03-3636-8292 / fax. 03-3636-8140
ホームページアドレス <https://www.nippon-chem.co.jp/>